

第21回 有機/無機接合研究委員会

日時：2024年6月25日（火）13:00～15:40

場所：日本橋ライフサイエンスビルディング 9階 911-913 会議室（東京都中央区）

プログラム

司会 松嶋 道也（大阪大学）

13:00～13:10 委員会議事

13:10～13:40

『リードフレーム粗化处理による樹脂密着性およびパワーサイクル耐量向上』（30分）

..... ○渡壁 翼、中村 瑤子、岩谷 昭彦、齊藤 まい、浅井 竜彦、郷原 広道（富士電機(株)）

13:40～14:20

『パワーモジュールのワイヤ接合部強化に向けたコーティング樹脂の特性評価』（40分）

..... ○南 尚吾、松尾 圭一郎、山本 哲也（(株)東芝）

14:20～14:30 休憩

司会 小山 真司（群馬大学）

14:30～15:00

『新規コンポジット銀ナノ粒子を用いた電極材料の作成および高放熱基板への応用』（30分）

..... ○大江 舞^{*1}、草野 浩幸^{*1}、川本 康和^{*1}、北 崇^{*1}、鈴木 好明^{*2}
（^{*1}(株)フェクト、^{*2}(地独)鳥取県産業技術センター）

15:00～15:40

『分子接合技術による異種材料接合とノンエッチング金属めっき』（40分）

..... ○平原 英俊、桑 静、會澤 純雄（岩手大学）

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。

一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会